

Technischer Bericht Nr. 64.110.07.0792.01
Rev. 00
vom 30. Juli 2007
(Deutschsprachige Übersetzung)

Auftraggeber:	G-Technologies Co., Ltd. Chaqiao Industrial District, Shiqi, Zhongshan City 528404, Guangdong Province, P.R. China
Herstellungsort:	wie Auftraggeber
Testgegenstand:	Produkt: Steuerungsplatine für Aufzüge Typ: MCU
Testspezifikation:	IEC 60664-1:1992+A1:2000+A2:2002 Anforderungen des Herstellers: Für die Signalverarbeitung, verbunden mit den Klemmen SDSL, CDSL, RDSL, PSL und CSUP des Steckverbinders XM5, ausschließlich der Signalspannungsseite der Optokoppler und der damit verbundenen anderen Schaltungsteile, gilt: - Kriechstrecke zwischen allen Leiterzügen mind. 4 mm - Abstand zwischen allen Leiterzügen mind. 3 mm
Zweck der Prüfung:	Test auf Übereinstimmung mit der Testspezifikation
Testergebnis:	Der Testgegenstand entspricht der Testspezifikation

Dieser Technische Bericht darf nur in vollem Wortlaut angeführt werden. Jegliche Nutzung für Werbezwecke bedarf der schriftlichen Genehmigung. Der Bericht ist das Resultat einer einmaligen Prüfung des Testgegenstandes und kann nicht allgemein auf die Qualität des Produktes im Produktionsprozess übertragen werden.

INTEC GmbH

MLC 8000 Aufzugsteuerung



1. Beschreibung des Testgegenstandes

1.1. Funktion

Spezifikation des Herstellers

Steuerungsplatine für Aufzüge

Modell:	MCU
Nennspannung für Eingänge:	230V~
Nennfrequenz:	50 Hz
Verschmutzungsgrad:	keine Herstellerangaben
Schutz gegen Feuchtigkeit:	IP4X

2. Auftrag

2.1. Auftragsdatum

22. Juni 2007

2.2. Erhalt des Prüfmusters, Ort

Das Prüfobjekt wurde am 11. Juli 2007 nach Guangzhou geschickt

2.3. Prüfdatum

11. bis 30. Juli 2007

2.4. Prüfort

Die Prüfung wurde in Guangzhou, Abteilung ELS, entsprechend des Auftrages durchgeführt.

2.5. Punkte der Nichteinhaltung oder Ausnahmen beim Prüfablauf

Keine

INTEC GmbH

MLC 8000 Aufzugsteuerung

3. Prüfergebnis

Die vorgelegte Einheit stimmt mit der Testspezifikation überein.

3.1. Positive Testergebnisse

Elektrische Sicherheit
Anforderungen des Herstellers

IEC 60664-1:1992+A1:2000+A2:2002
Anforderungen des Hersteller:

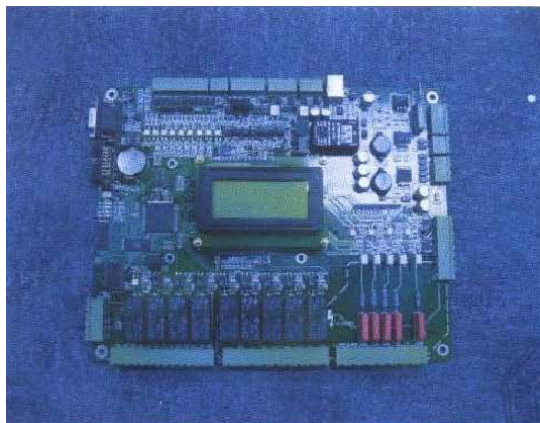
Für die Signalverarbeitung, verbunden mit den Klemmen SDSL, CDSL, RDSL, PSL und CSUP des Steckverbinders XM5, ausschließlich der Signalspannungsseite der Optokoppler und der damit verbundenen anderen Schaltungsteile, gilt:

- Kriechstrecke zwischen allen Leiterzügen mind. 4 mm
- Abstand zwischen allen Leiterzügen mind. 3 mm

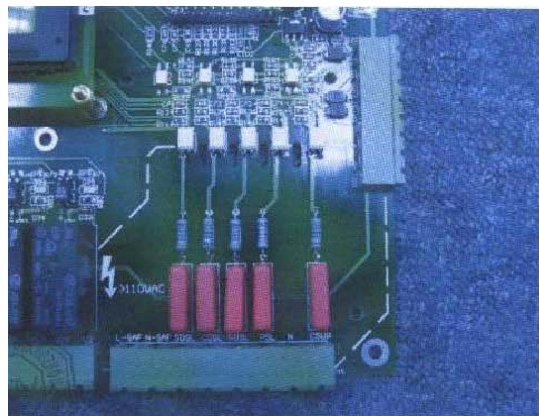
Prüfposition	Gemessen		Grenzwert	
	Kriechstrecke	Abstand	Kriechstrecke	Abstand
Zwischen Leiterzügen SDSL und CDSL	5,1 mm	5,1 mm	4,0 mm	3,0 mm
Zwischen den Pins des Steckverbinders	6,4 mm	8,0 mm	4,0 mm	3,0 mm
Zwischen Lötunkten des Steckverbinders	5,0 mm	5,0 mm	4,0 mm	3,0 mm

4. Anmerkung

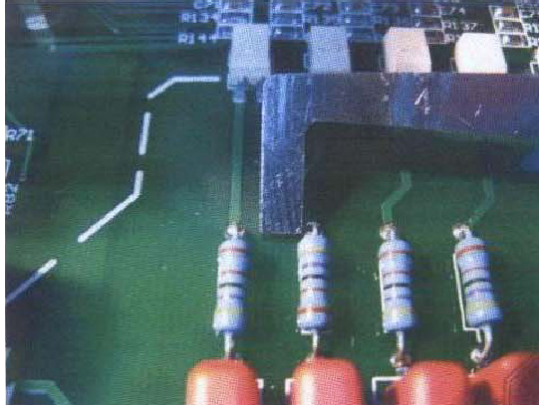
4.1. Messpunkte



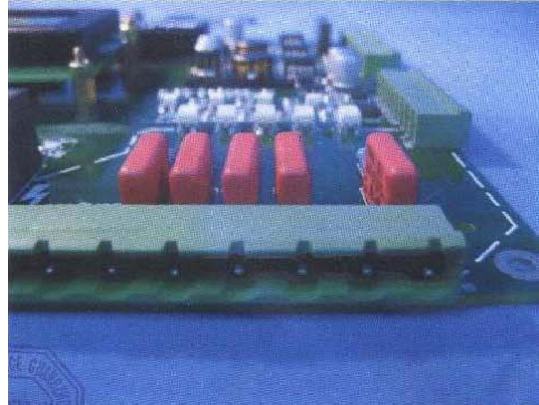
Platine MCU



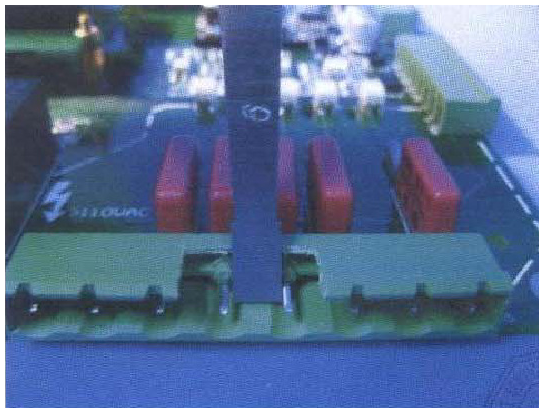
Zu messender Schaltungsteil



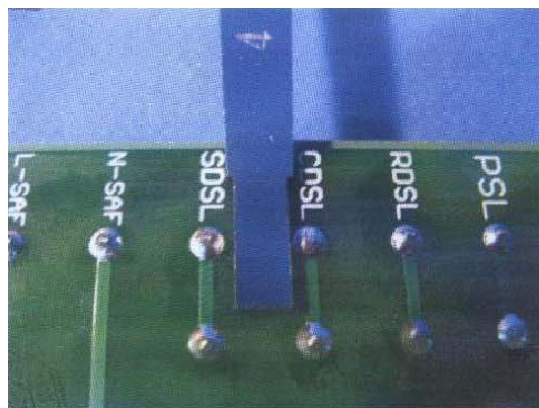
Kriechstrecke und Abstand zwischen den Leiterzügen, gemessen $> 4,0$ mm



Steckverbinder XM5



Kriechstrecke und Abstand zwischen den Pins des Steckverbinders XM5, gemessen $> 4,0$ mm



Kriechstrecke und Abstand zwischen den Lötstellen der Pins von Steckverbinder XM5, gemessen $> 4,0$ mm

TÜV Product Service Ltd. Guangzhou Branch
TÜV SÜD Group

Ingenieur: Johnny Guan

Technischer Bericht geprüft: Shaochang Liu